

2023-2029年中国挠性覆铜 板FCCL行业发展趋势与未来前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国挠性覆铜板FCCL行业发展趋势与未来前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202308/393283.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

挠性覆铜板是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面，通过一定的工艺处理，与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。

中企顾问网发布的《2023-2029年中国挠性覆铜板FCCL行业发展趋势与未来前景预测报告》共十四章。首先介绍了中国挠性覆铜板FCCL行业市场发展环境、挠性覆铜板FCCL整体运行态势等，接着分析了中国挠性覆铜板FCCL行业市场运行的现状，然后介绍了挠性覆铜板FCCL市场竞争格局。随后，报告对挠性覆铜板FCCL做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国挠性覆铜板FCCL行业发展趋势与投资预测。您若想对挠性覆铜板FCCL产业有个系统的了解或者想投资中国挠性覆铜板FCCL行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章挠性覆铜板的品种及主要性能要求

第一节按不同基材分类的FCCL品种

第二节按不同构成分类的FCCL品种

第三节按不同应用领域分类的FCCL品种

第四节FCCL品种的其它分类

第五节产品主要采用的标准及性能要求

一、FCCL管理体制

二、FCCL相关标准

三、FCCL的主要性能要求

第二章挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究

第一节三层型FCCL的制造工艺法及其特点

一、片状制造法

二、卷状制造法

第二节二层型FCCL的制造工艺法及其特点

一、涂布法

二、溅射电镀法

三、层压法

四、三种工艺法生产的2L-FCCL在性能、工艺特点方面的比较

第三节近年FPC的技术发展方面

一、二层型FCCL已成品种发展的主流

二、FCCL近年在技术方面的进步

第三章2023-2029年挠性覆铜板市场现状分析

第一节2023-2029年挠性覆铜板产业发展概述

一、挠性覆铜板产业发展概述

二、FCCL市场规模及结构

三、挠性覆铜板价格竞争分析

四、FCCL原材料形态结构发生变化

第二节2023-2029年挠性覆铜板区域市场分析

一、美国

二、日本

三、欧洲

四、韩国

五、中国台湾

第三节2023-2029年挠性覆铜板产业发展前景预测分析

第四章挠性覆铜板主要企业运营走势分析

第一节新日铁化学株式会社

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况

三、公司竞争优势分析

第二节宇部兴产株式会社

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况

三、公司竞争优势分析

第三节台湾律胜科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、公司竞争优势分析

第四节新扬科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售分析

三、公司竞争优势分析

第五节亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司化战略发展

第六节旗胜科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、公司竞争优势分析

第七节东丽世韩有限公司

一、公司发展基本概况

二、公司经营策略分析

第八节SD电线有限公司

第五章2023-2029年中国挠性覆铜板产业运营态势分析

第一节2023-2029年中国覆铜板产业发展总体概述

一、中国覆铜板主要产品概述

二、中国覆铜板生产发展历程

三、中国覆铜板生产发展现状

四、中国覆铜板全面调研

五、中国覆铜板技改科研成果

第二节2023-2029年中国挠性覆铜板产业发概况

一、中国挠性覆铜板产业发概况

二、中国挠性覆铜板生产情况分析

三、中国挠性覆铜板的产能与产量

四、中国挠性覆铜板企业销售状况

第三节2023-2029年挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析

第六章2023-2029年中国挠性覆铜板相关市场调查

第一节2023-2029年中国挠性印制电路业发展分析

一、柔性电路板相关概述

二、FPC产值及生产企业

三、我国FPC生产企业的现状

四、FPC多层挠性板的新技术

五、重庆彭水建柔性线路板基地

第二节二层型挠性覆铜板在LCD的IC驱动用COF市场现状与发展

一、驱动IC用COF

二、驱动IC用COF挠性基板性能特点及市场发展

三、COF挠性基板生产现状

第七章2023-2029年中国印制电路板制造所属行业经济运行状况

第一节2023-2029年中国印制电路板制造所属行业分析

第二节2023-2029年中国印制电路板制造所属行业总体规模分析

一、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业企业规模分析

二、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业人员规模统计

三、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业资产规模分析

四、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业负债规模分析

五、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业市场规模分析

第三节2023-2029年中国印制电路板制造所属行业供需平衡分析

一、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业产成品分析

二、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业供给区域分布

三、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业销售产值分析

四、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业需求区域分布

第四节2023-2029年中国印制电路板制造所属行业投资状况分析

一、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业投资增长分析

二、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业投资区域分布

三、2023-2029年不同规模印制电路板制造企业资产总额分析

第五节2023-2029年中国印制电路板制造所属行业获利能力分析

- 一、2023-2029年中国印制电路板制造所属行业利润总额分析
- 二、2023-2029年不同规模印制电路板制造企业获利能力分析
- 三、2023-2029年中国主要省区印制电路板制造所属行业获利能力

第六节2023-2029年中国印制电路板制造所属行业经营效益分析

- 一、2023-2029年印制电路板制造行业偿债能力分析
- 二、2023-2029年印制电路板制造行业盈利能力分析
- 三、2023-2029年印制电路板制造行业运营能力分析
- 四、2023-2029年印制电路板制造行业成长能力分析

第七节2023-2029年中国印制电路板制造所属行业成本费用分析

- 一、2023-2029年印制电路板制造行业销售成本分析
- 二、2023-2029年印制电路板制造行业销售费用分析
- 三、2023-2029年印制电路板制造行业管理费用分析
- 四、2023-2029年印制电路板制造行业财务费用分析

第八节2023-2029年中国印制电路板制造所属行业总体结构特征分析

- 一、2023-2029年印制电路板制造行业经济类型结构
- 二、2023-2029年印制电路板制造企业规模结构分析
- 三、2023-2029年印制电路板制造行业区域结构特征

第九节2023-2029年中国印制电路板制造行业集中度分析

- 一、行业资产集中度分析
- 二、行业销售集中度分析
- 三、行业利润集中度分析

第八章2023-2029年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口数据监测分析

第一节2023-2029年中国覆铜板及铜箔所属行业进口数据分析

- 一、2023-2029年中国覆铜板及铜箔进口数量情况
- 二、2023-2029年中国覆铜板及铜箔进口金额情况

第二节2023-2029年中国覆铜板及铜箔所属行业出口数据分析

- 一、2023-2029年中国覆铜板及铜箔出口数量情况
- 二、2023-2029年中国覆铜板及铜箔出口金额情况

第三节2023-2029年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口均价分析

第四节2023-2029年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口国家及地区分析

- 一、2023-2029年中国覆铜板及铜箔进口国家及地区分析

二、2023-2029年中国覆铜板及铜箔出口国家及地区分析

第五节2023-2029年中国覆铜板及铜箔所属行业进出口省市分析

一、2023-2029年中国覆铜板及铜箔进口省市情况

二、2023-2029年中国覆铜板及铜箔出口省市情况

第九章中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析

第一节广东生益科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第二节金宝电子(中国)有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第三节金安国纪科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第四节广东超华科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第五节山东金宝电子股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第六节无锡宏仁电子材料科技有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第七节广东汕头超声电子股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第八节胜宏科技（惠州）有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第九节诺德投资股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第十节广东嘉元科技股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业经营情况分析

三、企业产品概述

四、企业发展优势

五、企业发展战略

第十章2023-2029年中国印刷电路板所属行业市场运行分析

第一节2023-2029年中国印刷电路板行业发展概况

- 一、印刷电路板（PCB）分类及产业链
- 二、中国印刷电路板产量居首位
- 三、国内印刷线路板企业区域分布情况
- 四、印刷电路板技术发展水平及趋势
- 五、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群
- 六、重庆打造高技术印刷电路板产业高地

第二节2023-2029年中国印刷电路板市场发展分析

- 一、2023-2029年中国印刷电路板产值规模
- 二、2023-2029年中国印刷电路板产品结构
- 三、中国印刷线路板市场集中度分析
- 四、中国印刷电路板市场需求特点分析

第三节2023-2029年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析

- 一、国内PCB配套产业还需进一步完善
- 二、产品集中于中低端成本转嫁能力弱
- 三、企业基础技术与开发水平薄弱
- 四、行业无序竞争产品定价能力有限
- 五、PCB企业环保投入需进一步加强

第四节2023-2029年中国印刷电路行业发展对策分析

第十一章中国挠性覆铜板用主要原材料所属行业运行动态分析

第一节挠性覆铜板用绝缘基膜--PI薄膜

- 一、绝缘基膜的生产方式
- 二、FCCL发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求
- 三、FCCL用PI薄膜在品种和性能上的发展
- 四、挠性覆铜板用PI薄膜的市场需求情况

第二节挠性覆铜板用导电材料

- 一、各类铜箔的品种及特征

二、压延铜箔

三、电解铜箔

四、FCCL发展对铜箔性能提出更高的要求

第三节挠性覆铜板用胶粘剂

一、FPC用胶粘剂发展概述

二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的状况

三、环氧树脂粘合剂研究与应用的状况

四、聚酰亚胺粘合剂研究与应用的状况

五、FPC及FCCL用胶粘剂的主要生产厂家及品种

第四节挠性覆铜板用覆盖膜

第十二章中国挠性覆铜板用主要应用领域分析

第一节航空航天

一、航空航天现状

二、挠性覆铜板在航空航天应用分析

三、挠性覆铜板在航空航天应用趋势

第二节电脑

一、电脑现状

二、挠性覆铜板在电脑应用分析

三、挠性覆铜板在电脑应用趋势

第三节汽车

一、汽车现状

二、挠性覆铜板在汽车应用分析

三、挠性覆铜板在汽车应用趋势

第四节其他

第十三章2023-2029年中国挠性覆铜板行业发展前景预测分析

第一节2023-2029年中国挠性覆铜板行业发展趋势分析

一、印刷电路板行业预测分析

二、对未来FPC技术发展预测

三、FPC发展对FCCL提出更高性能的要求

第二节2023-2029年中国挠性覆铜板行业市场预测分析

一、覆铜板生产供给预测分析

二、挠性覆铜板供给预测分析

三、挠性覆铜板市场调查

第三节2023-2029年中国挠性覆铜板行业盈利能力预测

第十四章2023-2029年中国挠性覆铜板行业投资机会与风险分析

第一节2023-2029年中国挠性覆铜板行业投资环境分析

第二节2023-2029年挠性覆铜板行业投资机会分析

一、中国覆铜板行业投资情况分析

二、挠性覆铜板区域投资机会分析

三、挠性覆铜板行业投资吸引力分析

第三节2023-2029年中国挠性覆铜板行业投资风险分析

一、宏观经济风险

二、市场竞争风险

三、原材料市场风险

四、技术研发风险分析

第四节2023-2029年中国挠性覆铜板行业投资策略分析

图表目录：

图表：挠性聚酰亚胺覆铜板产品性能要求

图表：挠性聚酯覆铜板产品性能要求

图表：二层挠性覆铜板三种生产工艺对比情况

图表：2023-2029年挠性覆铜板销售及销售额情况

图表：2023-2029年新日铁化学株式会社公司经营

图表：2023-2029年新日铁化学株式会社公司经营

图表：2023-2029年台湾律胜科技股份有限公司经营

图表：2023-2029年新扬科技股份有限公司经营

图表：2022年新扬科技股份有限公司经营

图表：新扬科技股份有限公司

图表：2023-2029年旗胜科技股份有限公司经营

图表：中国大陆覆铜板产能区域分布情况

图表：按损耗因子分类的PCB材料

图表：中国覆铜板技改科研成果情况

图表：2023-2029年我国挠性覆铜板产量情况

图表：2023-2029年中国挠性覆铜板产量情况

图表：2023-2029年我国挠性覆铜板行业销售额情况

图表：2023-2029年我国挠性覆铜板产能利用率

图表：2023-2029年中国印刷电路板企业数量情况

图表：2023-2029年中国印刷电路板行业从业人员数量情况

图表：2023-2029年中国印刷电路板行业资产规模分析

图表：2023-2029年中国印刷电路板行业负债规模情况

图表：2023-2029年中国印刷电路板行业市场规模情况

图表：2023-2029年中国印刷电路板行业销售收入分析

图表：2022年国内印刷电路板需求区域分布情况

图表：2022年PCB行业部分并购案例情况

图表：2022年PCB项目投资地分布情况

图表：2023-2029年中国印刷电路板行业利润总额

图表：2023-2029年印刷电路板行业偿债能力指标

图表：2023-2029年印刷电路板行业盈利能力指标

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202308/393283.html>